

芯原微电子（上海）股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案

芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）致力于提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感。自公司 2025 年 4 月制定 2025 年度“提质增效重回报”行动方案以来，公司始终遵循方案宗旨，聚焦核心主业，稳步提高运营效率、完善公司治理规范、进一步加强投资者沟通和回报。为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司及全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，落实公司发展战略，切实履行上市公司的责任和义务，积极打造良好资本市场口碑，共同促进科创板市场平稳运行。

现将公司对 2025 年度“提质增效重回报”行动方案进展执行的评估情况及 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的主要措施公告如下：

一、2025 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况

自公司制定 2025 年度“提质增效重回报”行动方案以来，公司严格执行方案并取得了一定进展。公司持续推进核心技术的研发迭代，构筑技术先进性壁垒与核心竞争力；同时密切追踪市场趋势与技术发展动向，聚焦目标及关键市场，积极布局新技术研发，进一步强化公司科技创新能力与核心竞争力。具体情况如下：

（一）持续核心技术研发，不断迭代升级

公司在持续优化迭代现有核心技术的基础上，于报告期内进一步就生成式人工智能（AIGC）、数据中心、智驾系统、智慧可穿戴设备、物联网这几个关键应用领域，以及 Chiplet 技术进行深入的技术研发和产业化推进。

1) AIGC 应用领域

截至报告期末，芯原全球领先的 NPU IP 已在 91 家客户的 140 余款芯片中

获得采用，覆盖服务器、汽车、平板电脑、智能手机、智能家居、可穿戴设备等 10 余个市场领域。目前集成了芯原 NPU IP 的 AI 类芯片已出货近 2 亿颗。芯原最新一代 NPU 架构针对 Transformer 类模型进行了优化，既能高效运行 Qwen、LLAMA 类的大语言模型，也能支撑 Stable Diffusion、MiniCPM 等 AIGC 和多模态模型。报告期内，芯原超低能耗 NPU 已可为移动端大语言模型推理提供超 40 TOPS 算力，并已在知名企业的手机和平板电脑中量产出货。芯原的 NPU 还与自有的众多处理器 IP 深度集成，形成包括 AI-ISP、AI-Display、AI-VPU、AI-GPU、AI-DSP 在内的众多 AI 加速子系统解决方案。基于其可编程、可扩展特性，以及自有的创新 NeuroBrick 片上硬件加速解决方案，芯原的 NPU IP 还可针对不同应用场景极大优化客户芯片的 PPA 特性。报告期内，芯原的 AI-ISP 芯片定制方案（芯原提供架构设计、软硬协同设计和量产支持）已在知名企业的智能手机中量产出货。

公司基于 20 余年 Vivante GPU 的研发经验，所推出的具有自主知识产权的通用图形处理器（GPGPU）IP 可以支持大规模通用计算和 AIGC 相关应用，现已被客户采用部署至各类高性能 AI 芯片中，面向数据中心、高性能计算等应用领域。通过将自有的 GPU 和 NPU 技术进行流水线级的深度融合，芯原还推出了系列 AI-GPU（GPGPU-AI）IP，可灵活支持图形渲染、通用计算以及 AI 处理，为数据中心、云游戏、边缘服务器、AIGC 相关应用提供大算力通用处理器平台，并利用统一的软件接口和一体化的编译器，让用户可以使用标准编程接口来驱动不同的硬件处理器单元。报告期内，芯原正式发布了面向智慧汽车和边缘 AI 服务器应用的可扩展、高性能 GPGPU-AI IP，可高效支持大语言模型推理、多模态感知以及实时决策等复杂的 AI 工作负载。芯原的 GPU 和 GPGPU-AI IP 在全球范围内已进行了多次架构授权，在众多高性能计算产品中获得应用。

报告期内，公司还推出了 ZSP5000 系列 IP。该产品线基于公司第五代经硅验证的数字信号处理器（DSP）架构，采用高可扩展性和低功耗的设计，并针对计算机视觉、嵌入式人工智能等计算密集型应用进行了深度优化，结合架构的可配置能力，该系列 IP 可为各类边缘设备提供兼具能效优势和计算效率的优秀解决方案。

针对 AIGC 产业所面临的安全性和隐私性等问题，芯原还与谷歌合作以支持其新推出的开源项目 Open Se Cura。该项目是一个由设计工具和 IP 库组成的开源框架，旨在加速安全、可扩展、透明和高效的人工智能系统的发展。作为该项目基础设施的一部分，报告期内，芯原开发了多款面向特定应用的平台级解决方案，支持超低功耗空间计算，并提供优质、高效的 AIGC 输入（Token）。此外，芯原与谷歌基于之前 Open Se Cura 开源项目合作基础，还于报告期内共同打造了面向端侧大语言模型应用、基于 RISC-V 指令集的超低能耗 Coral NPU IP，这其中，谷歌提供开源技术，芯原提供企业级 IP、芯片设计及量产服务，为智能眼镜、可穿戴设备、AI 玩具等提供“轻量级、始终在线、超低能耗”的端侧 AI 解决方案。

在 2025 年前十大云服务提供商中，有七家采用了芯原的各类 IP 及技术服务。目前公司还正在进行基于 Chiplet 架构、面向 AIGC 应用的高性能计算芯片项目的研发。

2) 数据中心领域

芯原的视频转码加速解决方案已获得中国前 5 名互联网企业中的 3 家，以及全球前 20 家云服务提供商中的 7 家的采用。这其中，第一代视频转码平台已于 2021 年第二季度完成研发，并以 IP 授权、一站式芯片定制业务等方式获得多家客户的采用并量产出货。第二代平台一站式芯片定制项目已完成交付，平台在上一代基础上实现了技术全面升级：支持包括 AV1 在内的多格式 8K 视频转码，集成 AI 处理能力，搭载高性能多核 RISC-V CPU 与硬件加密引擎，现已成功导入国际领先芯片客户并实现量产。第三代平台已进入研发阶段，该平台定位为高性能异构计算平台，以高性能、低功耗、多场景适配为设计核心，深度融合 AI 加速、视频处理与实时控制能力，并集成 CPU、DSP、VPU、NPU、硬件加密模块及安全启动等多核心子系统，全面支撑 AI 推理、视频转码与边缘计算等复杂业务场景，同时还通过精细化电源管理及多电源域控制设计，显著优化系统能效表现。

3) 汽车电子领域

公司已耕耘汽车电子领域多年，从座舱到自动驾驶技术均有布局。芯原的

GPU IP 已经在汽车上获得了广泛的应用，包括信息娱乐系统、仪表盘、车身环视、驾驶员状态监控系统、ADAS、自动驾驶汽车等。多家全球知名的汽车 OEM 厂商都采用了芯原的 GPU 用于车载信息娱乐系统或是仪表盘；芯原的 VPU IP 已被 2024 年中国造车新势力 Top 8 榜单中 5 家所采用。

芯原的 ISP IP 自 2017 年正式推出以来，研发与车规认证工作同步进行，目前已有多款 ISP IP 通过车规认证，获得汽车客户的广泛采用。截至报告期末，芯原 ISP IP 已获全球 80 多家客户采用，其中包括 20 多家汽车公司，赋能超过百万个高级辅助驾驶系统摄像头。报告期内，芯原推出了基于 AI 技术的 ISP 调优系统 AcuityPercept，以智能优化图像处理参数，提升目标识别能力，从而提升 AI 感知系统的准确性和效率；此外，还发布了新一代 AI ISP 解决方案 ISP9000，除了利用 AI 图像处理算法 AI 降噪（AI NR）和 AI WDR 提供高图像质量和低功耗外，还高效支持多传感器，具备快速上下文切换和低延迟响应能力，同时优化输出以兼顾 NPU 处理和人眼视觉需求。上述产品将为车用摄像头提供更优秀可靠的图像信号处理能力，以支持快速发展的 ADAS 和自动驾驶应用。

芯原正在加速各类车规 IP 的认证进程。目前，公司的第一代 ISP IP 已获得 ISO 26262 汽车功能安全标准认证和 IEC 61508 工业功能安全标准认证；第二代 ISP 系列 IP 通过了 ISO 26262 ASIL B 和 ASIL D 认证；芯原的畸变矫正处理器 IP 通过了 ISO 26262 ASIL B 认证。报告期内，芯原的显示处理器 IP DC8200-FS、神经网络处理器 IP VIP9000Nano 和接口 IP MIPI C/D-PHY TX/RX IP 均获得了 ISO 26262 ASIL B 认证。公司其他 IP，包括数模混合 IP 和接口类 IP，也正在逐一通过各类车规认证的进程中。

公司的设计流程已获得 ISO 26262 汽车功能安全管理体系认证，可从芯片和 IP 的设计实现、软件开发等方面，为全球客户满足功能安全要求的车载芯片提供一站式定制服务。此外，芯原还推出了功能安全（FuSa）SoC 平台的总体设计流程，并基于该平台推出了智能驾驶辅助系统（ADAS）功能安全方案，完整的自动驾驶软件平台框架，以及车规级高性能智慧驾驶 SoC 设计平台。报告期内，公司正式发布了车规级高性能智慧驾驶 SoC 设计平台，并完成验证，在客户项目上获得成功实施，该平台可为自动驾驶和 ADAS 等高性能计算需求提供强

大的技术支持。

目前，公司已为某知名新能源汽车厂商提供了基于 5nm 车规工艺制程的自动驾驶芯片定制服务，正在积极推进智慧出行领域 Chiplet 解决方案平台研发。基于上述技术布局，芯原正在与一系列汽车领域的关键客户进行深入合作。

4) 智慧可穿戴设备领域

芯原从数年前就开始与该领域领先的企业合作，利用自身低功耗技术方面的优势，积极布局蓝牙耳机、智能手表/手环和 AI/AR/VR 眼镜，并已在芯片和终端产品中验证了芯原面向低能耗应用所打造的 nano 和 pico 系列低功耗 IP 组合。芯原还拥有面向智能手表、AR/VR 眼镜等始终在线（Always-on）的轻量化空间计算设备领域的极低功耗高性能芯片设计平台，可以打造适应不同功率模式的产品，满足超轻量、实时在线、低能耗以及全性能的全场景应用。

报告期内，公司推出了全新超低功耗的 GPU IP——GCNano3DVG，该 IP 具备 3D 与 2.5D 图形渲染功能，在视觉效果与功耗效率之间实现了卓越平衡，专为可穿戴设备及其他需要动态图形渲染的紧凑型电池供电设备而设计，如智能手表、智能手环、AI/AR 眼镜等。

报告期内，芯原与谷歌基于之前 Open Se Cura 开源项目合作基础，共同打造了面向端侧大语言模型应用、基于 RISC-V 指令集的超低能耗 Coral NPU IP，这其中，谷歌提供开源技术，芯原提供企业级 IP、芯片设计及量产服务，为智能眼镜、可穿戴设备、AI 玩具等提供“轻量级、始终在线、超低能耗”的端侧 AI 解决方案。

目前，芯原已为某知名国际互联网企业提供 AR 眼镜的芯片一站式定制服务，还有数家全球领先的 AI/AR/VR 眼镜客户正在与芯原进行合作。截至报告期末，已有 20 余家核心智能手表和 MCU 芯片客户采用了芯原的 IP，市面在售的 30 余款主流智能手表和 10 余款 AI 眼镜均采用了芯原的技术。

此外，芯原以自有的低功耗 IP 为核心基础，结合自身的软件和系统平台设计能力，还推出了一系列从芯片设计到参考应用的一体化可穿戴式健康监测平台级解决方案，可为客户提供含 BLE 协议栈、软件 SDK、算法、智能硬件和应用

程序等在内的不同层级的授权和定制设计服务，助力可穿戴设备在大健康领域的广泛应用。

5) 物联网领域

芯原持续优化和丰富自有的物联网无线连接技术平台。公司持续拓展其在 22nm FD-SOI 工艺上的射频类 IP 产品及平台方案布局，包括支持双模蓝牙、低功耗蓝牙 BLE、NB-IoT、多通道 GNSS 及 802.11ah 等物联网连接技术。所有射频 IP 均已获得客户芯片采用，且采用芯原 802.11ah、802.15.4g 和 GNSS 射频 IP 的客户芯片已量产。上述产品被广泛应用于智能家居、智能穿戴、高精度定位等领域。

FD-SOI 技术以其低功耗、高性能、高集成度的优势，在物联网领域获得了广泛应用。公司已深入布局 FD-SOI 技术十余年。截至报告期末，公司在 22nm FD-SOI 工艺上开发了超过 60 个模拟及数模混合 IP，种类涵盖基础 IP、数模转换 IP、接口协议 IP 等，已累计向 46 个客户授权了 300 多个/次 FD-SOI IP 核；并已经为国内外知名客户提供了 45 个 FD-SOI 项目的一站式设计服务，其中 36 个项目已经进入量产。报告期内，公司还基于 FD-SOI 的低功耗技术优势，持续开发针对如 Wi-Fi6、卫星通信、毫米波雷达和助听器等应用的技术平台。

6) Chiplet 技术

Chiplet 技术及产业化是芯原的发展战略之一，公司已于五年前开始布局 Chiplet 技术的研发。目前，公司正在以“IP 芯片化 (IP as a Chiplet)”、“芯片平台化 (Chiplet as a Platform)”和“平台生态化 (Platform as an Ecosystem)”理念为行动指导方针，从接口 IP、Chiplet 芯片架构、先进封装技术、面向 AIGC 和智慧出行的解决方案等方面入手，持续推进公司 Chiplet 技术、项目的发展和产业化，持续提升公司半导体 IP 授权和芯片定制业务的产业价值，拓展市场空间。

截至报告期末，公司已在基于 Chiplet 的生成式人工智能大数据处理和高端智驾两大赛道实现领跑，目前正在推进基于 Chiplet 架构、面向智驾系统和 AIGC 高性能计算的芯片平台研发项目。目前公司在 Chiplet 领域取得的切实成果包括：已帮助客户设计了基于 Chiplet 架构的 Chromebook 芯片，采用了 SiP (System in

Package) 先进封装技术, 将高性能 SoC 和多颗 IPM 内存合封; 已帮助客户的 AIGC 芯片设计了 2.5D CoWos 封装; 已设计研发了针对 Die to Die 连接的 UCIE 物理层接口, 并已顺利完成流片测试, 相关技术已被客户采纳将用于项目开发; 已和 Chiplet 芯片解决方案的行业领导者合作, 为其提供包括 GPGPU、NPU 和 VPU 在内的多款芯原自有处理器 IP, 帮助其部署基于 Chiplet 架构的高性能人工智能芯片, 该芯片面向数据中心、高性能计算、汽车等应用领域。此外, 为了应对先进封装技术可能出现的供应和成本等问题, 芯原已针对新一代面板级封装 (Panel level package) 技术进行了先行设计开发, 为接下来的规模量产做好了准备。本土封装厂也正在积极布局该封装技术, 芯原将与之携手, 共同打造更具成本效益且供应安全的先进封装解决方案。

(二) 人才培养

坚持引进和培养优秀人才是公司生存和发展的关键, 也是公司持续提高核心竞争力的基础。

结合长期技术发展战略和现有人才储备情况, 在外部人才引进方面, 公司不仅通过内部推荐、网络招聘等多种渠道吸纳有经验的优秀人才, 也通过每年线上及线下校园招聘会、“芯原杯”全国嵌入式软件开发大赛、“芯原杯”电路设计大赛、与各大重点高校联合开展技术和就业指导讲座及企业开放日, 搭建“海南大学-芯原智慧医养创新实验室”“海南大学-芯原医疗电子创新实验室”“浙江大学-芯原智能图形处理器联合研究中心”, 以及成立东南大学信息科学与工程学院、南京大学电子科学与工程学院、海南大学计算机科学与技术学院、海南大学生物医学工程学院、海南大学信息与通信工程学院、海南大学电子科学与技术学院的校外实习实训或教学基地等多种形式, 吸引并招募国内外顶尖高校的毕业生, 为公司持续稳定发展夯实人才储备。

在内部人才培养方面, 公司持续构建并运行完善高效的培训体系与公开透明的晋升机制, 通过线上线下相结合的技术与管理培训、专业技术及技术管理双通道发展等方式, 全面提升员工的综合能力; 积极营造良好的工作环境, 从企业文化、薪酬福利、人才激励等方面增强员工的凝聚力与归属感。

截至 2025 年 12 月末, 公司研发人员合计 1,839 人, 研发人员的占比为 89.40%,

研发人员中硕士及以上学历人员占比达 88.42%。公司中国大陆地区具有十年以上工龄的员工占比为 25%，员工平均年龄为 32 岁。依托上述行业及公司特征，公司的研发能力始终保持较高水平，已建成理论知识扎实、研发实力突出、实践经验丰富的研发团队，持续巩固业务竞争优势，构筑高水平竞争壁垒。

公司拥有丰富且优质的人才和技术储备，持续通过校园招聘招收优秀应届毕业生，优化人才梯队结构，为公司长远发展提供坚实保障。

2025 届校园招聘中，共 8,000 人参加了全球统一在线笔试，约 1,300 人进入面试环节，公司最终录用应届毕业生 100 余名，其中硕士毕业于 985、211 院校占比 97%，本硕均毕业于 985、211 院校占比 89%。2026 届校园招聘中，公司共录用 100 余名应届毕业生，硕士毕业于 985、211 院校占比提升至 100%，本硕均毕业于 985、211 院校占比提升至 94%。截至报告期末，近四年入职的应届生累计申请专利 116 项。得益于公司优异的招聘质量和高效的培养体系，近年录用的应届毕业生已完成内部培训，为今年已启动和即将承接的多个芯片重大项目提供了有力的人才支撑。未来随着行业逐步复苏，公司项目数量增加，这批研发人员将在各自岗位上发挥关键作用。

公司高度重视人才发展与雇主品牌建设，已连续五年获评“芯片行业最佳雇主”，体现了公司在行业竞争中的软实力。报告期内，公司在前程无忧雇主评选中蝉联“典范雇主”奖项并获评“员工关爱典范”单项大奖，并已连续两年荣获“人力资源管理杰出奖”之“杰出雇主”及“最佳培训实践”双料殊荣，同时获得“年度大学生喜爱雇主”奖项。此外，公司在报告期内再度荣获猎聘“上海年度非凡雇主”、牛客“NFuture 大学生最喜爱雇主”和芯雇主“年度雇主”奖项。

得益于公司优秀的企业文化，公司保持较高的人才稳定性。报告期内，芯原中国大陆地区员工主动离职率为 2.8%，显著低于 2025 年中国大陆半导体行业平均主动离职率 10.2%（怡安翰威特人力资本调研数据）。

（三）资源整合，完成收购逐点半导体，持续 RISC-V 产业生态发展

公司坚定实施发展战略，在持续推进内生式增长的基础上，积极探索通过投资、收购等方式，整合具备先进技术、优质设计资源及核心竞争力的半导体相关

企业与团队，实现资源优势互补，进一步夯实公司核心竞争力。报告期内具体情况如下：

1、联合共同投资人收购逐点半导体，高效完成资源整合并交割

报告期内，公司联合共同投资人对特殊目的公司天遂芯愿进行投资，并以天遂芯愿为收购主体收购逐点半导体的控制权。逐点半导体于 2004 年在张江成立，专注于移动设备视觉处理芯片、视频转码芯片和 3LCD 投影仪主控芯片及实施方案的开发和设计，是全球先进的创新视频、显示处理芯片和解决方案提供商。作为智能手机 AI 独立显示芯片引领者，逐点半导体拥有 160 多项国内外发明专利。

本次收购事项的共同投资人包括：华芯鼎新（北京）股权投资基金（有限合伙）（大基金三期载体之一，其管理人为华芯投资）；上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业（有限合伙）（上海三大先母基金之一）；北京屹唐元创股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京芯创智造二期创业投资基金（有限合伙）（亦庄国投旗下基金）；上海涵泽创业投资合伙企业（有限合伙）（即孚腾交大科技策源基金，由上海交通大学和上海国投共同发起设立的直投资基金）。

2026 年 1 月，上述收购事项已完成交割。交割完成后，公司享有天遂芯愿的控制权，天遂芯愿持有逐点半导体 100% 股份，逐点半导体纳入公司合并报表范围。本次收购强化公司视觉处理领域技术优势，进一步提升公司在端侧 AI ASIC 市场竞争力；公司将通过分布式渲染与 GPU 的结合，加强在端侧和云侧 AI ASIC 的布局。

2、深化 RISC-V 生态协同发展，赋能产业创新升级

报告期内，公司积极开拓 RISC-V 市场，基于芯原的半导体 IP 和芯片定制平台的技术赋能能力，持续提升芯原在相关领域中的地位与价值，并积极推动 RISC-V 产业生态的发展。

芯原已与赛昉科技、嘉楠科技、先楫半导体等多家 RISC-V 领先企业达成合作。截至报告期末，芯原的半导体 IP 已经获得 RISC-V 主要芯片供应商的 14 款芯片所采用；此外，芯原已为 25 家客户的 25 款 RISC-V 芯片提供了一站式芯片

定制服务，上述项目正陆续进入量产。同时，公司还基于 RISC-V 核推出了包含数据中心视频转码、可穿戴健康监测、物联网无线通信、带硬件安全支持的智能传感 SoC 等多个芯片设计平台，以及基于 RISC-V 核的硬件开发板，上述解决方案正逐步获得客户采用，将有助于推动 RISC-V 技术的商业化进程。

2018 年 9 月，由上海集成电路行业协会推荐芯原股份作为首任理事长单位牵头成立了中国 RISC-V 产业联盟（CRVIC），截至 2025 年 12 月底，会员单位已达到 204 家。2024 年，芯原联合芯来科技、达摩院共同发起成立了民办非企业单位——上海开放处理器产业创新中心（SOPIC），该中心专注于推动处理器技术，特别是基于开放指令集架构（如 RISC-V）的研发、生态建设和产业化应用。由中国 RISC-V 产业联盟和芯原共同主办的滴水湖中国 RISC-V 产业论坛已经成功召开了四届，每届会议集中发布 10 余款来自不同本土企业的国产 RISC-V 芯片新品，现已累计推广了 40 多款，量产率达 90%，广泛应用于消费电子、智能家居、可穿戴设备、通信、汽车、工业控制等多个领域。芯原还连续 4 年举办了基于 RISC-V 技术的“芯原杯”全国嵌入式软件开发大赛。大赛每年吸引来自 40 多所国内高校、累计 650 多支队伍参赛，为 RISC-V 产业发展起到了很好的人才引导和培养作用。

由上海开放处理器产业创新中心于 2025 年 7 月在上海主办的第五届“RISC-V 中国峰会”规模盛大，包括 1 场主论坛、9 场垂直领域分论坛、5 场研习会、11 项同期活动，以及 4,500 平方米未来科技展览区，汇聚来自 17 个国家的数百家企业、研究机构及开源技术社区参会。主论坛当日共计 3,000 余人线下参会，12.5 万人次线上观看论坛直播；当日媒体原创报道达 200 余篇，会后媒体原创报道总数达 425 篇；参会总人次为 8188 人。该中心还联合清华大学、北京大学、浙江大学、上海交通大学、复旦大学、西安交通大学、同济大学、山东大学、华东师范大学、电子科技大学、上海大学和上海科技大学这 12 所高校，历时半年精心编撰和发布了《RISC-V 导论：设计与实践》研究生选修课开源课件，助力 RISC-V 专业人才培养。

（四）优化运营效率，新签订单连创公司历史新高，在手订单连续九个季度保持高位

公司技术能力业界领先，持续获得全球优质客户的认可，2025年第二、第三、第四季度新签订单金额分别为11.82亿元、15.93亿元、27.11亿元，单季度新签订单金额三次突破历史新高，其中2025年第四季度较第三季度进一步增长70.17%。2025年全年，公司新签订单金额59.60亿元，同比增长103.41%，其中AI算力相关订单占比超73%，数据处理领域订单占比超50%且主要来自于云侧AI ASIC及IP。

截至2025年末，公司在手订单金额达到50.75亿元，较三季度末的32.86亿元大幅提升54.45%，且已连续九个季度保持高位。公司2025年末在手订单中，量产业务订单超30亿元，量产业务的规模效应显著，订单的持续转化将为公司未来盈利能力逐步提升奠定坚实基础。2025年末在手订单中，预计一年内转化的比例超80%，近60%为数据处理应用领域订单且主要来自于云侧AI ASIC及IP。

自公司制定2025年度“提质增效重回报”行动方案以来，公司持续优化研发、存货、应收账款及资金等运营管理事项，定期就上述重点工作向管理层汇报研讨，以提升运营效率。

（五）再融资顺利完成发行，按计划推进募投项目投入，加强募集资金管理

公司于2024年1月经2024年第一次临时股东大会、于2024年12月经2024年第三次临时股东大会审议通过2023年度向特定对象发行股票事项（以下简称“向特定对象发行股票”），公司向特定对象发行股票事项拟募集不超过180,685.69万元（含本数），募集资金投资投向为AIGC及智慧出行领域Chiplet解决方案平台研发项目和面向AIGC、图形处理等场景的新一代IP研发及产业化项目。报告期内，公司成功完成本次向特定对象发行股票事项，发行股票总数量为24,860,441股，发行价格为72.68元/股，募集资金总额为人民币1,806,856,851.88元，扣除本次发行费用（不含税）人民币26,594,726.32元后，募集资金净额为人民币1,780,262,125.56元。

“AIGC及智慧出行领域Chiplet解决方案平台研发项目”，将针对数据中心、智慧出行等市场需求，从Chiplet芯片架构等方面入手，使公司既可从事半

导体 IP 授权业务，同时也可升级为 Chiplet 供应商，充分结合公司一站式芯片定制服务和半导体 IP 授权服务的技术优势，提高公司的 IP 复用性，有效降低了芯片客户的设计成本、风险和研发迭代周期，可以帮助客户快速开发自己的定制芯片产品并高效迭代，发展核心科技基础，保障产业升级落实。

“面向 AIGC、图形处理等场景的新一代 IP 研发及产业化项目”，将通过研发新一代自主可控的高性能 IP，包括面向 AIGC 和数据中心应用的高性能图形处理器（GPU）IP、AI IP、新一代集成神经网络加速器的图像信号处理器 AI-ISP 等，增强我国自主研发设计具备高性能芯片的能力，为本土集成电路设计企业提供自主可控的 IP 授权，推动国内集成电路设计产业高质量发展，同时致力于打造完善的应用软件生态系统，满足下游市场大模型研发对高性能、低能耗的技术需求。

公司严格管理募集资金使用，确保募集资金按照既定用途得到充分有效利用。2025 年 6 月，公司完成再融资发行工作，相关募投项目研发工作进展顺利。

通过本次向特定对象发行股票，公司将借助资本市场平台增强资本实力、优化资产负债结构，本次募投项目将在业务布局、研发能力、财务能力、长期战略等多个方面夯实可持续发展的基础，有利于增强公司的核心竞争力、提升盈利能力，为股东提供良好的回报并创造更多的经济效益与社会价值，推动公司长远发展。

（六）完善内部控制体系建设，全面梳理《公司章程》及现有内部控制制度，取消监事会并完成换届选举

自公司制定 2025 年度“提质增效重回报”行动方案以来，公司不断健全公司治理结构，对内控体系进行完善，提升公司治理水平，为公司股东合法权益的保护提供有力保障。

2025 年 7 月，根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司完成监事会取消工作，监事会的职权由董事会审计委员会行使。此外，公司全面梳理《公司章程》

及现有内部控制制度，完成了《公司章程》修订并制定及废止公司部分内部管理制度。具体内容详见公司于2025年7月15日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、调整董事会人数、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记暨修订、制定及废止公司部分内部管理制度的公告》(公告编号：2025-028)。

2025年7月，公司完成了第三届董事会换届选举及公司高级管理人员聘任工作。具体内容详见公司于2025年7月31日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2025-041)。

(七) 制定《市值管理制度》，完成实施回购股份方案，加强与投资者的沟通

公司始终重视与广大投资者的交流互动，并致力于维护良好的投资者关系。公司于2025年4月25日召开第二届董事会第二十一次会议暨2024年年度董事会，审议通过了《关于制定公司<市值管理制度>的议案》。公司基于《市值管理制度》，切实推动公司提升投资价值，践行“以投资者为本”的发展理念，诚实守信、规范运作、稳健经营，在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，增强投资者对公司的投资信心，结合公司经营情况及财务状况等因素，公司于2025年7月审议并完成了以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购股份数量28.70万股，回购金额2,483.19万元，回购价格区间85.80元/股~87.00元/股。上述回购股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，并在公司披露股份回购实施结果公告日之后的三年内予以转让。

自公司制定2025年度“提质增效重回报”行动方案以来，公司于2025年4月29日上证路演中心平台召开了2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，于2025年8月25日召开2025年半年度业绩说明会，并于2025年10月28日召开2025年第三季度业绩说明会。2025年度，公司举办了28场投资者关系活动，完成18

个“上证 e 互动”平台问题回复，通过各种形式与投资者积极沟通，加深投资者对于公司经营情况的了解，增强投资者对公司的认同感，增进交流互信，树立市场信心。

此外，公司于 2025 年 4 月 26 日发布了《2024 年社会责任报告》，向社会公众及投资人全面展示公司积极履行 ESG 管治的责任和义务，在社会责任、员工关怀等方面的表现，有助于市场更充分的了解公司经营和发展情况。

（八）完善投资者回报机制

公司于 2023 年 12 月制定并披露了《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》，综合考虑公司未来战略发展目标的基础上，兼顾各类股东意愿，结合公司的盈利情况和现金流量状况、经营发展规划及企业所处的发展阶段、资金需求情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素，依据《公司章程》的要求，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，并对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的合理性、连续性和稳定性。

公司董事会对上述股东回报规划进行了持续评估及审阅，确保股东回报规划内容不违反《公司章程》确定的利润分配政策。公司将根据经营情况与发展规划，严格执行分红政策，在符合条件的情况下积极推动对广大股东的利润分配以及现金分红，强化对投资者的回报机制。

（九）制定 2025 年限制性股票激励计划，以长效激励驱动长远发展，强化管理层与股东的利益共担共享约束并强化“关键少数”的责任

公司长期秉持“全员持股”的理念，始终将股权激励视为整体薪酬体系的重要组成部分，从而实现员工在公司的长远发展。在公司科创板上市前就已设立期权、员工持股平台等多种股权激励方式，上市后又进一步推进两次第二类限制性股票计划，持续为员工搭建与公司共成长、共分享的价值平台。2025 年度，公司完成两次限制性股票归属工作，合计归属股份 65.2750 万股。

在此基础上，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司于 2025 年 10 月制定了 2025 年限制性股票激励计划，拟向激励对

象授予不超过 811.6250 万股限制性股票，并于 2025 年 11 月完成首次授予 643.8500 万股限制性股票。

公司始终重视“关键少数”在公司生产经营过程中的重要作用，持续强化“关键少数”的履职责任。2025 年 7 月，公司完成了第三届董事会换届选举及公司高级管理人员聘任工作，公司将督促“关键少数”积极参与上交所等监管机构举办的各种培训，加强学习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，及时传达最新监管精神、处罚案例、市场动态等信息，强化“关键少数”合规意识，推动公司持续规范运作。

公司制定了科学合理的薪酬机制，董事会薪酬与考核委员会负责研究并监督对公司高级管理人员的激励、考核和方案实施。2025 年度，董事会薪酬与考核委员会将结合公司经营情况、战略发展等目标的综合完成情况对公司高级管理人员进行绩效业绩考核，确保高级管理人员的薪酬水平与工作职责、业绩考核以及公司经营情况等指标合理挂钩，以强化管理层与股东的利益共担共享。

二、2026 年度“提质增效重回报”行动方案主要措施

（一）聚焦主营业务，提升科技创新能力

公司是一家依托自主半导体 IP，为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体 IP 授权服务的企业。自 2001 年设立以来，公司始终深耕主营业务，作为全球领先的半导体 IP 授权服务提供商和芯片定制服务提供商，目前拥有自主可控的图形处理器 IP（GPU IP）、神经网络处理器 IP（NPU IP）、视频处理器 IP（VPU IP）、数字信号处理器 IP（DSP IP）、图像信号处理器 IP（ISP IP）和显示处理器 IP（Display Processing IP）这六类处理器 IP，以及 1,700 多个数模混合 IP、射频 IP 和接口 IP。

芯原在传统 CMOS、先进 FinFET 和 FD-SOI 等全球主流半导体工艺节点上都具有优秀的设计能力。在先进半导体工艺节点方面，公司已拥有 14nm/10nm/7nm/6nm/5nm/4nm FinFET 和 28nm/22nm FD-SOI 工艺节点芯片的成功流片经验。此外，根据 IPnest 在 2025 年的最新统计，2024 年，芯原半导体 IP 授权业务市场占有率位列中国大陆第一，全球第八；2024 年，芯原的知识产权

授权使用费收入排名全球第六。根据 IPnest 的 IP 分类和各企业公开信息，芯原 IP 种类在全球排名前十的 IP 企业中排名前二。2020 年，公司在科创板上市时，曾被誉为“中国半导体 IP 第一股”；随着公司业务在 AI 芯片定制领域获得快速增长，目前公司已被业界誉为“AI ASIC 龙头企业”。

2026 年度，公司将持续深耕主营业务，聚焦半导体 IP 与一站式芯片定制核心领域，多措并举推进业务优化与能力提升，不断巩固核心业务竞争优势，稳步提升市场份额，夯实行业领先地位。同时，公司将以科技创新为核心驱动，赋能公司高质量发展与业绩稳健增长。

为了保持公司半导体 IP 储备和一站式芯片定制业务的竞争优势，并根据发展战略进行研发布局以实现未来跨越式发展，使公司成为业界领先的芯片设计技术研发、授权和服务平台，公司将从技术研发、人才培养、资源整合这几个方面开展工作。具体的经营计划如下：

1、技术研发

公司将以技术发展趋势和市场应用需求为导向，除了持续升级和迭代现有的 IP 产品线，以及强化先进的芯片设计能力以外，还将围绕四个核心方向展开技术研发工作。一是持续巩固云端领域优势并拓展端侧 AI 市场，继续加强在视频转码、AI 加速及高性能计算等方向的技术实力，同时加大对端侧 AI 领域的投入，进一步布局 AI 手机、AI PC 等存量市场以及 AI 眼镜、AI 玩具等新兴场景，并逐步拓展具身智能与机器人等边缘计算领域，提供从 IP 授权、芯片定制、软件设计到量产管理的芯片设计与制造全栈支持。二是进一步深化智慧出行领域布局，依托已有的车规级 IP 组合及芯片设计平台，持续推进核心 IP 的研发和车规认证工作，助力客户构建下一代高性能车载计算平台。三是积极推动 Chiplet 技术的产业化落地与生态构建，聚焦于 AIGC 大数据处理和智慧出行两大关键领域，依托 UCIE 接口 IP 及先进封装应用技术积累等，与产业链伙伴协同推进 Chiplet 解决方案的规模化应用。四是依托 FD-SOI 工艺拓展物联网平台与垂直行业布局，围绕低功耗无线连接平台持续完善技术方案，面向物联网、消费电子、汽车、医疗等行业开发定制化的平台解决方案。

2、人才培养

人才是公司发展的重要资源。公司将结合未来发展战略目标，通过优质的校园招聘和社会招聘，引进各类优秀人才。公司将持续优化人力资源管理体系，如强化企业文化建设、制定科学高效的培训体系等，提升员工企业归属感，扎实推进公司人才梯度建设。同时，公司将持续优化绩效管理体系，依托资本市场制定长效的股权激励计划，充分调动员工工作积极性与创造性，为公司创造更多价值。此外，公司还将全面推进 AI 工具在企业运营中的深度融合，通过专项培训与实践应用，帮助员工适应技术发展趋势，进一步提升整体运营效率。

3、资源整合

公司以芯片设计服务为主要业务，作为集成电路设计企业和制造企业之间的桥梁，在整个产业链中具有重要的沟通和衔接作用，因此对整个产业链的全局发展有着较为全面的认知。公司将充分利用这一优势，积极推进产业链上下游的合作，推动产业的生态建设，加强产业间的融合，提升公司的产业地位和整体竞争力。同时，公司还将继续依托自身平台化公司对行业发展趋势的全面理解，视业务需要择机进行与公司战略发展方向相一致的投资或并购。

(二) 优化运营效率，巩固订单高位，实现高质量发展

公司始终高度重视业务拓展与市场开拓工作，积极布局目标市场，稳步推进国际化发展战略落地。2025 年第二、第三、第四季度新签订单金额分别为 11.82 亿元、15.93 亿元、27.11 亿元，单季度新签订单金额三次突破历史新高，其中 2025 年第四季度较第三季度进一步增长 70.17%。2025 年全年，公司新签订单金额 59.60 亿元，同比增长 103.41%。截至 2025 年末，公司在手订单金额达到 50.75 亿元，较三季度末的 32.86 亿元大幅提升 54.45%，且已连续九个季度保持高位。

依托良好的新签订单规模及在手订单储备，公司将持续巩固订单良性发展态势，并依托优质客户资源，持续深化与各领域龙头企业的合作，充分发挥技术优势与创新能力，稳步提升公司在相关领域的行业地位与核心竞争力。2026 年度，公司将结合自身发展战略及产业发展趋势，持续优化业务布局，提升运营效率，不断增强盈利能力。此外，公司将持续强化研发、存货、应收账款及资金等方面的运营管理，提高经营效益与资金使用效率。

（三）推进 H 股发行上市，加强募集资金管理，按计划推进募投项目投入

为满足公司业务发展的需要，持续吸引并集聚优秀的研发与管理人才，深入推进国际化战略，打造国际化资本运作平台，进一步提升公司资本实力，公司于 2026 年 3 月 10 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等相关议案，拟发行境外上市股份 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市（以下简称“本次 H 股发行上市”）。本次 H 股发行上市所募集资金在扣除发行费用后，将用于（包括但不限于）：关键技术及主要服务的研发投入，发展全球营销网络和生态建设，战略投资或收购，补充营运资金和一般公司用途等用途。

本次 H 股发行上市是公司构建 A+H 双资本平台的重要举措，有利于拓宽国际化融资渠道，增强长期资本实力。未来，公司将进一步完善公司治理结构，借鉴境外资本市场成熟的监管经验与治理理念，提升公司规范化运营水平与信息披露质量，增强公司在资本市场的核心竞争力与投资价值，实现公司股东利益最大化，为公司可持续高质量发展奠定坚实基础。公司将依据法律法规相关规定，根据本次发行上市的后续进展情况及时履行信息披露义务。

2026 年度，公司将结合 A 股再融资及 H 股发行上市募集资金项目规划及市场情况，持续推进募投项目的研发投入。公司将严格执行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件以及《芯原微电子（上海）股份有限公司章程》《芯原微电子（上海）股份有限公司募集资金管理办法》的规定，严格管理募集资金使用，确保募集资金按照既定用途得到充分有效利用。公司、保荐机构、存管银行将持续对公司募集资金使用进行检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。

（四）完善内部控制体系建设

2026 年度，公司将进一步健全治理结构，优化业务流程，并结合法律法规的更新及公司实际经营情况，持续完善内控体系，明确相关部门及人员的职责权限，深入推进治理工作，提升公司治理水平，切实保障公司股东的合法权益。

（五）强化投资者沟通交流，切实保障投资者合法权益

公司始终重视通过多维度与广大投资者沟通交流，建立了公开、公平、透明的投资者沟通渠道，并致力于维护良好的投资者关系。2026年度，公司将继续通过业绩说明会、投资者邮箱、投资者专线、“上证e互动”平台等各种形式与广大投资者沟通，同时将积极通过图文简报等可视化形式对年度报告等定期报告进行解读，提高可读性，以加深投资者对于公司经营情况的了解，增强投资者对公司的认同感，增进交流互信，树立市场信心。

公司将依据《市值管理制度》相关要求，以提升公司发展质量为本，践行“以投资者为本”的核心理念，持续提高信息披露质量与透明度。必要时，公司将积极采取有效措施稳定并提振投资者信心，推动公司投资价值与内在发展质量相匹配。

（六）完善投资者回报机制

2026年度，公司将在综合考虑公司未来战略发展目标的基础上，兼顾各类股东意愿，结合公司的盈利情况和现金流量状况、经营发展规划及企业所处的发展阶段、资金需求情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素，依据《公司章程》的要求，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，并对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的合理性、连续性和稳定性。公司将根据经营情况与发展规划，严格执行分红政策，在符合条件的情况下积极推动对广大股东的利润分配以及现金分红，强化对投资者的回报机制。

（七）强化管理层与股东的利益共担共享约束并强化“关键少数”的责任

公司推崇全员持股理念，重视员工的归属感，鼓励员工和公司共发展。2026年度，公司将通过2025年限制性股票激励计划的实施，以长效激励驱动公司战略发展，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，促进公司核心人才队伍的稳定，从而有助于公司长远发展，维护股东权益。

公司始终重视“关键少数”在公司生产经营过程中的重要作用，持续强化“关键少数”的履职责任。2026年度，公司将持续督促“关键少数”积极参与上交

所等监管机构举办的各种培训，加强学习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，及时传达最新监管精神、处罚案例、市场动态等信息，强化“关键少数”合规意识，推动公司持续规范运作。

公司制定了科学合理的薪酬机制，董事会薪酬与考核委员会负责研究并监督对公司高级管理人员的激励、考核和方案实施。公司已于第三届董事会第十次会议暨 2025 年年度董事会会议上审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，合理确定董事、高级管理人员的薪酬结构和水平。董事会薪酬与考核委员会将结合公司经营情况、战略发展等目标的综合完成情况对公司高级管理人员进行绩效业绩考核，确保高级管理人员的薪酬体系符合相关法律法规、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的要求，薪酬与公司经营业绩、个人业绩相匹配，激励高级管理人员积极为公司创造价值，以强化管理层与股东的利益共担共享。

（八）其他措施

公司将持续推进“提质增效重回报”行动方案的落地实施与效果评估，并严格履行信息披露义务。2026 年度，公司将着力精细化管理体系建设，持续深化主营业务领域布局；加大核心技术研发投入力度，巩固行业领先地位，逐步增强盈利能力；公司管理层将秉持科学决策、高效执行的原则，全面提升企业经营效益与资本市场价值，切实维护全体股东的合法权益。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

芯原微电子（上海）股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日